

气派科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司 2024 年度生产经营情况

随着半导体行业 AI 算力芯片、汽车电子、消费电子需求韧性凸显，叠加库存去化接近尾声，半导体行业呈现温和复苏态势。2024 年公司紧跟市场需求，不断调整产品结构，优化客户结构，全力导入新客户，销售订单有所增加，同时公司持续致力于提高生产效率，综合毛利率有所回升。报告期，公司营业收入实现增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损减少。公司主要经营管理情况如下：

1、公司主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 6.67 亿元，同比增长 20.25%；归属上市公司股东的净利润为-10,211.37 万元，同比减亏 2,885.32 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,112.36 万元，同比减亏 3,249.35 万元。

2、采取积极进取的营销策略，加大市场推广力度，开拓头部新客户

随着 2024 年 AI 技术的迅猛发展与广泛应用，AI 终端需求呈现出爆发式增长态势。这一趋势有力带动了笔记本、智能手机、智能电视、可穿戴设备等消费电子市场的显著增长。众多品牌纷纷推出搭载 AI 功能的产品，开启了新一轮的换机热潮。公司产品主要以消费电子领域为主，公司积极利用此次行情的恢复，持续关注客户需求和市场变化，抢抓不断回暖的市场机遇，加强与客户的沟通和服务工作，努力争取订单。报告期，公司实现封装测试销售量 105.71 亿只，同比增长 17.69%。

3、加强新产品、新技术开发力度，持续丰富产品种类

（1）报告期，在晶圆测试方面，完成了第三代半导体、电源管理、MCU、Nor-Flash、LDO等产品系列的测试开发和量产；引进 Laser Trim 设备，增加 DC/DC、电源管理 IC 等模拟类器件的测试范围；新增 OTP 测试流程，MCU 以及 Nor-Flash 产品测试量产。

（2）在高密度大矩阵引线框封装技术方面，公司持续扩大高密度大矩阵引线的产品覆盖，报告期，公司完成 SOP、TSSOP、SOT89 的高密度大矩阵集成电路封装技术的开发，SOP、TSSOP 均已大批量生产，SOT89 完成设计审核、项目立案、和产线架设并通线。

（3）报告期内，在生产工艺技术方面，公司从材料及材料组合、生产效率、质量控制等方面，不断提升工艺技术，提升产品可靠性，同时实现降本增效。

（4）报告期内，在功率器件封装测试方面，完成了全塑封的 TO247 碳化硅 MOSFET 芯片封装测试工艺开发；产品通过可靠性考核，取得客户的认可；申请并获得授权专利两项。

报告期，公司申请了 53 项专利，其中发明专利 13 项；获得授权的专利 50 项，其中发明专利 13 项。

4、持续推进精益生产管理，降本增效

报告期，公司将持续推进精益生产管理扎根生产运营系统，通过对生产流程进行深入分析，找出其中的瓶颈和浪费环节，进行流程再造和优化；通过精细化的成本管理和控制，降低生产过程中的各项成本。通过对生产流程、物料管控、人力成本控制等方面控制公司生产运营成本，实现降本增效。

5、持续完善质量管理体系，确保产品质量

在报告期内，公司高度重视员工质量意识的培育，积极组织了一系列形式多样、内容丰富的质量意识培训活动。通过生动的案例分析、专业的理论讲解以及实际操作演练，让每一位员工深刻认识到质量不仅是企业的生命线，更是赢得市场竞争、树立良好品牌形象的关键所在。同时，员工们也系统地掌握了与岗位相

关的质量知识和操作技能，为保障产品质量奠定了坚实的基础。

公司充分借鉴并运用六西格玛、精益生产等国际先进的质量管理工具和方法，构建了完善的数据收集与分析体系。通过对生产过程中的各项数据进行深入挖掘和精准分析，准确识别出影响质量的关键因素，并针对性地对生产流程进行优化和改进，实现了质量管理水平的持续提升。

此外，公司还着力加强与客户和供应商的紧密沟通与深度协作。积极倾听客户的需求和反馈，与客户共同探讨并制定符合市场发展趋势和客户个性化需求的质量标准和要求。同时，与供应商建立了长期稳定的合作关系，共同制定严格的原材料质量标准，确保原材料的品质稳定可靠，从源头上保障产品质量能够达到甚至超越客户的期望。

6、健全内部控制和风险管理体系

在报告期内，公司严格执行内部控制政策和程序，有效规范员工的日常行为，使其在工作中遵循既定的准则和规范，促进了各部门之间的深度协同与高效配合，打破部门壁垒，形成强大的工作合力。形成了严密的内部控制机制，有力地防范内部舞弊和违规行为的滋生，维护了企业内部的公平公正和良好秩序。通过去除冗余环节、简化繁琐流程，实现资源的合理配置和高效利用，从而显著提高工作效率，降低不必要的运营成本，为公司创造更为丰厚的经济效益，增强企业在市场中的竞争力。

二、2024 年度董事会的运行情况

（一）董事会尽责履职情况

2024 年公司召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有效执行，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第十五次会议	2024 年 3 月 12 日	《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十六次会议	2024 年 3 月 28 日	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

			《关于评估独立董事独立性的议案》 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2024 年公司及其控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于聘任公司审计部负责人的议案》 《关于审议公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》 《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
3	第四届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 22 日	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
4	第四届董事会第十八次会议	2024 年 5 月 22 日	《关于终止 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的议案》 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 《关于聘任王羊宝先生为公司副总经理的议案》 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第十九次会议	2024 年 8 月 23 日	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
6	第四届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》

（二）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《气派科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、公司未来发展规划

展望 2025 年，在全球半导体产业"AI+ "革命浪潮的驱动下，消费电子市场正迎来新一轮结构性复苏机遇。公司将充分释放三年行业低周期积蓄的体系化势能，全方位激活组织活力、深化客户价值、筑牢质量根基、降本增效，于行业回暖周期实现发展提升。

1、构建大客户“一企一策”管理，筑牢价值增长护城河

头部客户的高要求是公司的发展驱动力，依托行业头部客户合作期间积淀的信任基础，公司实行“一企一策”管理，创新客户服务范式。通过提高定制化解决方案能力、全生命周期服务响应等差异化竞争策略，持续提升在高附加值客户群体中的战略供应商地位。

深化“技术-市场”双轮驱动模式，建立以客户需求为牵引的快速技术迭代机制，以能够在先进封装领域中形成优势，扩大先进封装市场份额。针对头部客户的深度定制化需求，建立需求洞察-技术响应-服务增值的全周期赋能体系，通过技术储备与服务机制的双向加持，与客户共同开发新工艺新产品，培养高成长性客户；同步探索行业生态的创新路径，借力新兴产品领域的爆发式增长，构建多维价值交互网络，将客户触点转化为技术迭代的灵感源泉与市场洞察的信息枢纽。

2、锻造质量文化内核，夯实可持续发展根基

质量管控体系将全面融入公司决策链条，构建预防型质量管理生态。强化全员质量主体意识培育，将高质量文化深植于研发、生产、服务全服务链。持续完善质量追溯与持续改进机制，梳理制程过程和客诉问题并建立质量事故案例复盘机制，建立制程防火墙实行改善对策落实度稽核，为客户构建安全可靠的质量信

任屏障。

3、推进成本精进

在行业成本压力常态化背景下，公司将以“人工材料降本+管理提效”为核心抓手，通过精细化的成本管理和控制，降低生产过程中的成本。在人力配置中强化考核，系统破解生产运营中的隐性材料损耗与效率衰减，实现运营成本结构性优化与价值创造能力双维跃升，打造兼具成本韧性与市场穿透力的可持续竞争优势。

4、深化人才强企计划，激活组织创新动能

人才是企业最宝贵的战略资源，更是封测行业攻坚克难的锋锐利剑，面对集成电路封测行业“技术密集+人才密集”的双重属性特征，公司将构建人才发展与业务深度咬合的生态系统。通过职责定界、完善考核机制、优化人才价值评价体系，打造兼具工匠精神与创新视野的复合型人才团队。重点推进跨部门协同作战能力升级，打破传统职能壁垒，为封装技术攻坚提供可持续的人才保障。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日